

汽车制造商将至少在 2023 年底之前遭受芯片短缺

汽车行业和半导体制造商警告称，在向电动汽车“不可阻挡”的转变中，芯片供应将出现紧张。



领先汽车集团和芯片制造商警告称，随着向电动汽车的加速转变，全球汽车业明年将遭遇半导体短缺。

美国芯片制造商 Onsemi 首席执行官哈桑内·埃尔-库里(Hassane El-Khoury)表示，由于需求强劲，该公司已至少到 2023 年底，已“售罄”碳化硅芯片(SiC)。碳化硅是一种先进的功率半导体，主要用于电动汽车。

“你现在做什么都无法改变 2023 年，” 这位世界领先汽车芯片制造商之一的老板说。“到 2023 年，我们将每个季度、每个月都增加产能，以满足客户需求。”

汽车芯片生产商英飞凌 (Infineon) 首席执行官约亨·哈内贝克 (Jochen Hanebeck) 最近在慕尼黑的一次活动上就供应问题发出了类似警告。他说：“我确实预计短缺会持续很长时间。”

汽车制造商也在为自己的问题做准备。斯特兰蒂斯 (Stellantis) 按销量计全球第四大汽车制造商，其首席执行官 Carlos Tavares 曾表示，芯片限制明年将继续困扰汽车行业。

对汽车芯片的需求提振了安森美 (Onsemi) 和英飞凌，以及意法半导体、恩智浦半导体和 Nexperia 等制造商。

英飞凌上月将未来几年的营收增长预期从 9% 上调至 10% 以上，但没有给出具体的时间表。

这家德国芯片制造商还宣布了其最大单笔投资，投资 50 亿欧元，将在德累斯顿建造一家工厂，生产用于汽车和其他行业的模拟、混合信号和功率半导体。

埃尔-库里表示，安森美正在捷克的罗兹诺夫、韩国釜山和美国新罕布什尔州的工厂扩大生产，该公司估计，明年这些工厂的产能将增加30%。

“我们与很多客户签订了长期供应协议，我们正在建设能力，首先支持这些客户，”他补充说。

对汽车芯片的需求，主要是由燃油汽车的互联性功能增强和向电动汽车的转变推动的。随着内燃机逐渐被淘汰，向电动汽车的转变很可能会进一步加速。

用于制造碳化硅芯片的领先碳化硅芯片衬底材料供应商 Wolfspeed 的首席执行官格雷格·洛(Gregg Lowe)表示，从内燃机向电动汽车的转变是“不可阻挡的”。

“我们预计，到本世纪末，功率半导体——特别是碳化硅功率半导体——的复合年增长率可能达到14%，这意味着我们所有人都将尽可能快地奔跑，努力赶上需求。”

汽车芯片的乐观前景与为智能手机和个人电脑供应半导体的其他行业形成了鲜明对比。

包括台积电(TSMC)、英特尔(Intel)和三星(Samsung)在内的这些集团都遭遇了需求下降。

台积电已将今年的计划资本支出削减约 10%，至 360 亿美元。台积电是全球最大的芯片代工制造商，为苹果(Apple)、谷歌和亚马逊(Amazon)等公司供应芯片。